

半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目厂房建设项目 施工总承包补充公告

半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目厂房建设项目施工总承包（项目编号：JG2025-5450）已于 2025 年 11 月 29 日发布招标公告，现对原招标文件作如下修改调整，如原招标文件内容与本补充公告内容存在不一致的，以本补充公告内容为准，原招标文件中其他内容不变。

一、招标公告部分：

条款	原文	现文
招标公告第九条投标人合格条件第 4 点	<u>投标人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包壹级或以上资质；</u>	<u>投标人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包二级（或以上）资质；</u>

二、招标文件部分：

条款	原文	现文
招标文件第五章 技术条件（工程建设标准）第二点	二、工程材料、设备质量技术要求（详见附件 1）	修改详见补充公告附件 1

三、本项目的投标登记时间、投标文件递交时间、电子光盘备用递交时间、投标文件解密时间及开标时间和场地安排等请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布的本项目的日程安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

附件：1. 工程材料、设备质量技术要求

